

证券代码： 300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长曹建伟 2、董事/总裁何俊 3、独立董事傅頔 4、副总裁/财务总监/董事会秘书陆晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、曹总你好，目前碳化硅衬底这块与天岳先进对比，产品上有哪些区别，两者之间这块业务会有竞争吗？碳化硅行业这块市场增量空间大概有多大。 尊敬的投资者，您好。公司 6-8 英寸碳化硅衬底材料技术及规模处于国内前列，量产的 6-8 英寸碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平，并成功研发 12 英寸导电型碳化硅晶体。受益于晶体生长及加工设备的高度自给，设备和工艺高度融合，公司的碳化硅衬底材料业务在技术工艺调整、产能投放以及成本控制方面取得竞争优势，并能够根据碳化硅材料下游应用领域的更多探索而灵活调整，快速适配行业发展需求。同时，随着光学技术的发展，半绝缘型碳化硅材料有望在消费电子端打开新的应用市场，公司紧抓行业发展趋势，积极布局研发光学级碳化硅材料，已掌握 8 英寸光学级碳化硅晶体的稳定工艺，并积极推进技术和工艺创新，力求早

	日实现 12 英寸光学级碳化硅衬底材料产业化。随着碳化硅产业链的发展，叠加新技术持续催生下的新应用不断涌现，碳化硅产业的市场空间将持续扩大。感谢您的关注。 2、请问董事长，目前公司半导体业务的收入占比是多少？去年光伏行业产品的收入情况怎么样？ 尊敬的投资者，您好。2024 年年报营业收入构成中的“设备及其服务”收入为 133.63 亿元，包括了半导体集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备及改造服务项目收入；“材料”收入为 33.46 亿元，包括了碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、半导体坩埚、光伏坩埚等材料收入。感谢您的关注。 3、晶盛机电除公司传统领域之外，是否布局其他高科技方向，或实施技术转型 尊敬的投资者，您好。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。在半导体装备板块，公司布局了集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备三大业务；在半导体衬底材料板块，公司布局了碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、金刚石三大业务；在半导体耗材及零部件板块，公司布局了石英坩埚、石英制品、金刚线、半导体精密零部件业务。在行业下游需求增长以及半导体产业链国产化进程加快的发展趋势下，公司半导体业务快速发展。感谢您的关注。 4、12 英寸半导体单晶炉是否国际领先 尊敬的投资者，您好。在集成电路装备领域，公司 12 英寸半导体单晶炉产品质量达国际先进水平，国内市占率领先；同时，公司全自动单晶硅生长炉产品入选国家半导体器件专用设备领域企业标准“领跑者”榜单。感谢您的关注！ 5、展望一下 2025，半导体设备与耗材的订单形势，非光伏设备 尊敬的投资者，您好。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。
--	---

	在半导体装备板块，公司布局了集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备三大业务；在半导体衬底材料板块，公司布局了碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、金刚石三大业务；在半导体耗材及零部件板块，公司布局了石英坩埚、石英制品、半导体精密零部件业务。在行业下游需求增长以及半导体产业链国产化进程加快的发展趋势下，公司半导体业务快速发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 33 亿元（含税）。详细业绩信息请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。 6、光伏冬天还有多久，存货跌价和应收账款收不回来怎么管理。坏账都能够给全部销售人员发工资了 尊敬的投资者，您好。光伏行业短期的供需错配使得竞争加剧，叠加国际贸易壁垒影响，光伏产业链各环节产品价格下降，降本增效成为产业链各环节创新发展的迫切需求，更高效率和智能化水平的创新型设备将促进落后产能出清，重塑产业健康发展生态。公司面对目前的行业状况，在市场开拓过程中，通过加强尽调等多渠道了解目标客户经营情况，重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，在手订单客户多为行业龙头及具备较强竞争力的上市公司或大型企业，同时，公司执行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，持续跟踪客户财务状况，加强收款，以降低订单履约风险。感谢您的关注。 7、公司流动性枯竭了，股东们一致要求拿出部分利润来回购股票，增加流动性 尊敬的投资者，您好。2022 年至今，公司实施两次股份回购，累计使用自有资金 19,924.65 万元，累计回购股份 3,926,374 股。未来若有回购计划，公司将按照相关法律法规及信息披露要求履行相关信息披露义务。感谢您的关注。 8、何总，您好。请问“拟建年产 1000 片金刚石芯片导热用晶圆项目”是属于实验项目还是小规模产业化项目？ 尊敬的投资者，您好。目前该项目处于研发试制阶段。金刚石凭借其超宽禁带、高载流子迁移率、高击穿电场、高热导率以及优异的化学稳定性和机械性能，能够在极端条件下高效运行并解决传统半导体材料面临的
--	---

	诸多瓶颈问题。尤其是其高热导率，有效解决高功率、高集成度半导体器件的散热难题，提高器件的可靠性和使用寿命。公司看好后续的金金刚石热沉片的应用市场，同时在钻石培育技术上实现了新突破，成功完成了 10 克拉级钻石的培育，为加快大尺寸培育钻石产业化进程奠定基础，也将进一步促进公司新材料业务发展。感谢您的关注。 9、董事长：前几年业绩很好，今后怎么保证业绩稳定或者少降？把规划、亮点等正向信息结合经营数据披露给股民，也不是所有信息含糊其辞。 谢谢 尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局。公司未来将继续稳健经营、坚持科研创新，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注。 10、@董事长曹建伟请问今年以来公司主要业务版块营收贡献有什么变化？下一步主营方向是什么？ 尊敬的投资者，您好。2024 年年报营业收入构成中的“设备及其服务”收入为 133.63 亿元，包括了半导体集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备及改造服务项目收入；“材料”收入为 33.46 亿元，包括了碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、半导体坩埚、光伏坩埚等材料收入。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 33 亿元（含税）。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。未来将继续稳健经营、坚持科研创新，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注。 11、光伏冬天还有多久，存货跌价和应收账款收不回来怎么管理 尊敬的投资者，您好。光伏行业短期的供需错配使得竞争加剧，叠加国际贸易壁垒影响，光伏产业链各环节产品价格下降，降本增效成为产业链各环节创新发展的迫切需求，更高效率和智能化水平的创新型设备将促进落后产能出清，重塑产业健康发展生态。公司面对目前的行业状况，在市场开拓过程中，通过加强尽调等多渠道了解目标客户经营情况，重点发
--	--

	展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，在手订单客户多为行业龙头及具备较强竞争力的上市公司或大型企业，同时，公司执行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，持续跟踪客户财务状况，加强收款，以降低订单履约风险。感谢您的关注。 12、您好，请问公司 2024 年全年（1）主营业务产品半导体装备、半导体衬底材料、半导体耗材和零部件中应用于光伏行业的营业收入占比是多少，以及同比情况；（2）截至 2024 年末，在手订单情况？ 尊敬的投资者，您好。2024 年年报营业收入构成中的“设备及其服务”收入为 133.63 亿元，包括了半导体集成电路装备、化合物半导体装备、新能源光伏装备及改造服务项目收入；“材料”收入为 33.46 亿元，包括了碳化硅衬底材料、蓝宝石材料、半导体坩埚、光伏坩埚等材料收入。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 33 亿元（含税）。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。受益于半导体行业全球格局变化，公司半导体设备业务订单量持续增加，半导体材料业务规模持续提升。感谢您的关注。 13、请问曹董事长及各位公司领导：如何看待贵公司近一年来公司股价一直跌跌补补，公司股价是否真实反映公司内在价值？能否象公司冠名的马拉松一样跑向成功的终点？ 尊敬的投资者，您好。二级市场股票交易受多种因素综合影响。公司重视市值管理，未来将继续稳健经营、坚持科研创新，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注。 14、晶盛什么时候开始 尊敬的投资者，您好。感谢您对晶盛机电的关注。 15、请曹总介绍下未来两年半导体设备和材料业绩预期和发展路线 尊敬的投资者，您好。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 33 亿元（含税）。公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体
--	---

	耗材及零部件领域。受益于半导体行业全球格局变化，公司半导体设备业务订单量持续增加，半导体材料业务规模持续提升。详细信息请关注公司披露的定期报告，感谢您的关注。 16、请问，这么好的发展优势，为什么股价走势这么差？难道公司不做市值管理吗？ 尊敬的投资者，您好。二级市场股票交易受多种因素综合影响。公司重视市值管理，未来将继续稳健经营、坚持科研创新，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注。 17、我来提问，为何股价如此跌跌不休 尊敬的投资者，您好。二级市场股票交易受多种因素综合影响。公司重视市值管理，未来将继续稳健经营、坚持科研创新，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注。 18、不回购吗 尊敬的投资者，您好。2022 年至今，公司实施两次股份回购，累计使用自有资金 19,924.65 万元，累计回购股份 3,926,374 股。未来若有回购计划，公司将按照相关法律法规及信息披露要求履行相关信息披露义务。感谢您的关注。
附件清单（如有）	
日期	2025-05-13